文章编号:0258-7025(2001)06-0494-03

808 nm 波长高功率阵列半导体激光器

薄报学¹² 高 欣² 王 玲² 曲 轶² 高鼎三¹

(1吉林大学电子工程系集成光电子学国家联合重点实验室; 长春光机学院高功率半导体激光国家重点实验室 长春 130023)

提要 报道了采用 MBE 外延生长方法制备的叠层阵列 CW 工作型高功率半导体激光器。激光器的生长结构采用 经过优化的单量子阱渐变折射率分别限制波导结构,激光器芯片结构为标准的 CM 条,注入因子设计为 60%。叠 层装配采用了具有高效散热能力的水冷结构。经初步测试,叠层器件的阈值电流为 12 A,直流 30 A 驱动电流下的 输出功率达 40 W 斜率效率为 2.2 W/A。器件中心激射波长为 810 nm,光谱宽度(FWHM)为 6 nm。 关键词 叠层阵列,半导体激光器,高功率 中图分类号 TN 365 文献标识码 A

808 nm Wavelength High Power Semiconductor Laser Arrays

BO Bao-xue^{1 2} GAO Xin² WANG Ling² QU Yi² GAO Dingsan¹

(¹National Key Lab of Integrated Optoelectronics, Department of Electronic Engineering, Jilin University;²National Key Lab of High Power Semiconductor Lasers, Changchun Institute of Optics and Fine Mechanics, Changchun 130023)

Abstract High power semiconductor laser stack arrays , grown by MBE have been prepared. The epitaxial structure for LD is an optimized SQW GRIN SCH structure , and cm bars are made with a fill factor of 60%. A LD stack assembly with water cooling is formed to obtain an effective heat delivery ability. The following results are preliminarily obtained : I_{th} of the stack lasers is 12 A , CW output power can reach to 40 W at 30 A ; FWHM of the lasing spectrum is 6 nm with a central wavelength of 810 nm , and the slope efficiency(η_s) is 2.2 W/A.

Key words stack array, semiconductor laser, high power

1 引 言

高功率半导体激光器在微加工、信息处理和国 防尖端技术领域有着十分广泛的用途^{12]},除了通 常的抽运 Nd:YAG,Nd:YVO4等固体激光器,以获得 高效、紧凑、可靠的固体激光器,满足激光测距、制导 及微加工的需求外,还可以直接用于激光雷达成像、 电子焊接、生物组织辐照等方面。获得高功率半导 体激光器的关键在于低阈值激光器结构设计、高质 量的半导体外延生长过程和芯片工艺、具有良好散 热的装配结构。由于 MBE MOCVD等半导体外延生 长技术的发展,对器件生长结构的控制已经变得十 分容易,生长厚度精度达到了单原子层量级,组份精 度可以控制在2%以内。外延技术的提高为器件新 型结构的设计与优化提供了至关重要的条件,并由

收稿日期 2000-02-14; 收到修改稿日期 2000-04-10

此发展了多量子阱、单量子阱、渐变波导、应变结构、 量子点、量子线等新结构器件。目前的高功率半导 体激光器多采用具有低阈值特点的单量子阱渐变折 射率分别限制结构³¹。叠层阵列装配是半导体激光 器实现高功率输出的一个重要方式。对于 CW 型工 作器件或高占空比工作器件,有效散热是激光器获 得高效输出和进行可靠工作的重要前提。本文报道 的器件采用了高质量的 MBE 外延生长方法,器件结 构为经过优化考虑的单量子阱分别限制线性缓变波 导结构 装置结构为自行设计的具有高效散热能力 的水冷型叠层结构。

2 激光器结构及器件工艺

激光器采用 GaAs/AlGaAs 体系材料 图 1 为 808 nm 波长 GaAs/AlGaAs 单量子阱分别限制结构激光 器的结构示意图。量子阱激光器由于其阱内载流子

28 卷

分布的状态密度呈台阶状分布,降低了激光器实现 粒子数反转所需的载流子浓度,使量子阱结构激光 器具有较大的非线性增益,因而设计良好的量子阱 结构激光器一般均可实现低阈值激射。理论计算表 明,在激光器的波导损耗和镜面输出损耗足够小的 条件下,单量子阱结构器件具有最小的激射阈值电 流密度。激光器内波导采用线性渐变的梯度折射率 结构,既有利于注入载流子的有效收集,也有利于增 加光斑尺寸,降低器件的端面光功率密度,提高激光 器的功率输出水平。为了较好地降低波导内由于掺 杂引起的吸收损耗,激光器的外限制层采用了梯度 掺杂技术,从外限制层的中心至内波导层的掺杂浓 度线性降低二分之一。



图 1 GaAs/AlGaAs 单量子阱分别限制结构激光器的 结构示意图

Fig.1 Schematic structure of GaAs/AlGaAs SQW SCH lasers

激光器的结构生长采用了 MBE 方法 ,生长系统 为 V80H。衬底为偏向 111 A 约 2°的(100)取向 GaAs 衬底,衬底刻蚀坑缺陷密度小于 200/cm²。衬 底经过速装室(200℃),预备室(450℃)的去气送入 生长室进行器件的结构生长 其顺序依次为 300 nm n⁺ - GaAs 缓冲层(Si 掺杂浓度:2×10¹⁸ cm⁻³),150 nm 厚线性渐变 N-Al_{0.1→0.55}Ga_{0.9→0.45}As 过渡层(Si 掺杂浓度 2×10¹⁸ cm⁻³) 0.6 µm 厚 N-Al_{0.55}Ga_{0.45}As 外限制层(Si掺杂浓度线性渐变:1~0.5×10¹⁸ cm⁻³),80 nm 厚线性渐变内波导层 Al_{0 55→0 3} Ga0.45→0.7As(非故意掺杂),15 nm 厚 Al0.3Ga0.7As 垒 层(非故意掺杂),10 nm 厚 Al0.07 Ga0.93 As 有源层(非 故意掺杂),15 nm 厚 Al_{0.3}Ga_{0.7}As 垒层(非故意掺 杂) 80 nm 厚线性渐变内波导层 Al_{0.3→0.55}Ga_{0.7→0.45} As(非故意掺杂) 0.6 μm 厚 P-Al_{0.55}Ga_{0.45}As 外限制 层 Be 掺杂浓度线性渐变:0.5~1.0×10¹⁸ cm⁻³), 0.6 µm 厚 P-Al_{0 55}Ga_{0 45}As 外限制层(Be 掺杂浓度:1

× 10^{18} cm⁻³), 100 nm 厚线性渐变 *P*-Al_{0.55→0.1}Ga_{0.45→0.9}As过渡层(Be掺杂浓度:2× 10^{18} cm⁻³),100 nm 厚*p*⁺-GaAs 层(Be掺杂浓度:1× 10^{19} cm⁻³),15 nm 厚*p*⁺⁺-GaAs 欧姆接触层 Be掺杂 浓度 5×10¹⁹ cm⁻³),在整个外延生长过程中,外限 制层的生长温度为 700°C,GaAs 层的生长温度为 600°C,有源层的生长温度为 680°C,生长温度的转变 是在线性渐变层内同步进行的。生长速率 $v_{GaAs} =$ $1.0 \mu m/h, v/Ш 速流比控制在近临界状态。$

激光器条宽为 11 mn(cm-条),激射区宽度为 10 mm ,其中激射条单元宽度为 60 µm ,周期为 100 µm。 为了防止阵列器件中可能存在的横向光增益,采用标准光刻技术和湿法化学腐蚀方法在激光器激射单 元条之间形成光隔离沟道(腐蚀至下限制层),同时以 SiO₂ 为掩蔽膜制备出电极条形窗口。P 面和 N 面 分别蒸镀 CrAu ,AuGeNi 合金电极后解理成 800 ~ 1000 µm 腔长的激光器条,然后在器件的两个端面 分别镀以 Si/SiO₂ 高反射膜(HR ~ 90%)和 SiO₂ 单层 减反射膜(AR ~ 10%)。激光器芯片 P 面向下装在 镀 In 的铜热沉上。

3 激光器阵列装配及特性

cm条阵列激光器工作时的热功率密度很大,一 般多采用无氧铜制备的铜热沉作为激光器条的直接 散热介质 ,也有采用人造金刚石或 BeO 作为激光器 的直接散热介质的报道。与激光器芯片直接焊接的 热沉对激光器的高功率工作特性有着至关重要的影 响,它主要决定了激光器有源区与激光器外散热片 或冷却液之间的温度梯度。我们采用了安装面经过 精密抛光的无氧铜热沉,有效保证了激光器条与热 沉之间的均匀焊接,使芯片工作时产生的热量得到 均衡散发,降低了不均匀焊接引起的局部热饱和。 激光器条工作时的局部温升对器件有着致命性损 伤 因为局部温升使该处的有源区带隙变窄 加剧了 此处的电流注入 形成温升的恶性循环 此种情况在 一般的单激射条器件中是不存在的。为了安装方 便 ,无氧铜热沉的外尺寸为 25 mm × 25 mm。厚度设 计为 2 mm 主要是为了激光器的二维高密度装配。 图 2 为两个 cm 条激光器叠层装配的结构示意图 热 沉采用了液(本实验中为蒸馏水)冷散热技术。根据 激光器的热耗散功率,可以在给定的水温升(一般小 于 2℃)计算出具体的水流量要求,实验中我们针对 双 cm 条器件 40 W 光功率输出、60 W 热功率耗散的 情况,冷却水流量定为0.5 L/min。



图 2 双 cm 条激光器叠层装配的结构示意图

Fig.2 Assembly diagram of double cm-bar stack lasers

图 3 为一个双 cm 条叠层阵列激光器的 P-I 特 性曲线及其光谱分布。激光器的驱动电源为一个最 大输出电流为 30 A 的连续可变恒流电源。激光器 的光输出通过一积分球收集 经衰减后由 Si 探测器 接收,并由 x-y 记录仪得到激光器的 P-I 特性曲线。 从图中可以看出,我们制备的阵列激光器具有较高 的斜率效率(约2.2 W/A),器件在最大驱动电流下 其输出曲线(受到电源限制)还保持着良好的线性, 没有出现功率饱和现象或器件的局部击穿损坏 ,说 明:1)器件内部产生的热量得到了有效散发,有源 区结温升较小 尚没有明显影响到有源区载流子的 注入效率。2) cm 条器件的外延材料具有较好的均 匀性,且热沉与装配工艺满足了 cm 条激光器均衡 散热的要求。从激光器的发射光谱可以看出,由于 具有较多的发光单元,且单元激射条之间存在不可 避免的材料不均匀性的温度分布 ,使得叠层阵列激 光器的激射光谱宽度较单条型激光器有明显增加。 视激光器的条宽不同,一般单条型大功率激光器的 激射光谱宽度(FWHM)为1~2 nm。



图 3 双 cm 条叠层阵列激光器的 *P-I* 特性曲线 *a*) 及其光谱分布(*b*)

Fig. 3 *P-I* characteristics (*a*) and spectrum distribution (*b*) of double cm-bar stack lasers

4 结 论

我们在完成高质量单量子阱渐变折射率结构 808 nm 波长 GaAs/AlGaAs 激光材料的 MBE 生长的 同时,进行了 cm 条器件的工艺制作,并在此基础上 初步组装了叠层阵列半导体激光器,获得了连续 40 W 的光功率输出,为以后研制更高功率的半导体激 光器奠定了基础。

参考文献

- Rogers L., Macomb S. Indus. Diode laser target manufacturing. Laser Solutions for Manufacturing, 1999, 14 (6) 25 ~ 28
- 2 Mc Euen K., Indus. Diode lasers solve soldering problems. Industrial Laser Rev., 1998, 13(2):16~18
- 3 Peng Y. H., Wang B. Z. et al.. Design of quantum structure stripe lasers for low threshold current. Opt. & Quantum Electron., 1999, 31(1) 23 ~ 28